

元器件失效分析，垂直燃烧试验

产品名称	元器件失效分析，垂直燃烧试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	70.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

元器件失效分析，垂直燃烧试验

开封方法有机械方法和化学方法两种,按封装材料来分类，微电子器件的封装种类包括玻璃封装(二极管)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。

机械开封

化学开封5、显微形貌像技术

光学显微镜分析技术

扫描电子显微镜的二次电子像技术

电压效应的失效定位技术

半导体主要失效机理分析

电应力（EOD）损伤

静电放电 (ESD) 损伤

封装失效

引线键合失效

芯片粘接不良

金属半导体接触退化

钠离子沾污失效

氧化层针孔失效